

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2025]33号

关于召开 2025 年度全国半导体设备和材料标准化技术委员会 材料分技术委员会年会的通知

各位委员、各会员单位及相关单位：

为全面贯彻党的二十届四中全会精神，落实中共中央、国务院《国家标准化发展纲要》及相关产业政策要求，进一步强化标准化工作的基础性、战略性、引领性的作用，推动半导体材料行业可持续的高质量发展，根据国家市场监督管理总局、工业和信息化部以及中国有色金属工业协会下达的有关标准制修订计划的文件精神和标委会工作需要，现定于 2025 年 11 月 25 日~11 月 28 日在山东省济南市召开 2025 年度全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会年会，请全体委员务必出席会议，同时请各会员单位、各起草单位及相关单位派代表参会。现将会议有关事宜通知如下：

一、会议日程和会议内容

- 11 月 25 日，全天报到。
- 11 月 26 日，上午 8:30~12:00 举行全体大会，会议内容如下：
 - 领导讲话。

② 全国半导体材料标准化分技术委员会秘书处作 2025 年度工作报告。

③ 表彰 2025 年度全国半导体材料分标委会“技术标准优秀奖”和“先进工作者”。

④ 行业技术交流及研讨。

3、11 月 26 日，下午 13:30~18:00 继续全体大会，会议内容如下：

① 终审 2025 年 4 月以来审定完成的标准项目。

② 审议半导体材料标准体系。

③ 论证 2026 年度半导体材料标准计划项目。请所有项目提出单位按照《关于征集 2025 年度全国半导体材料标准化分技术委员会年会论证标准项目计划的通知》（半材标委[2025]22 号）的要求，提前准备相关论证材料。秘书处将于年会前汇总所有需要论证的新计划项目，会议期间原则上不再接收新项目建议。

4、11 月 27 日，上午 8:30 开始分组会议，会议内容如下：

对《硅单晶单位产品能源消耗限额》等 8 项半导体材料国家和团体标准进行审定和讨论（具体项目见附件）。请各标准负责起草单位于 11 月 17 日前将相关标准稿件发送至秘书处邮箱(tc203sc2@cnsmq.com)，由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 11 月 20 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载会议资料。

5、11 月 28 日早餐后返程。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2025 年 11 月 25 日。

2、报到地点：济南绿地美利亚酒店（山东省济南市槐荫区齐州路 2477 号，0531-55626666）。

3、乘车路线：① 济南遥墙机场：乘坐机场巴士 3 号线至济南西公交枢纽站，步行 500 米到达酒店；乘出租车到酒店约 44 公里，约 90 元。② 济南东站：乘坐轨道交通 3 号线至八涧堡站，换乘轨道交通 2 号线至王府庄

站，换乘轨道交通1号线至济南西站，步行500米到达酒店；乘出租车到酒店约30公里，约75元。③ 济南站：乘坐K167路公交车至济南西站东广场站，步行500米到达酒店；乘出租车到酒店约13公里，约40元。④ 济南西站：步行500米到达酒店。

三、会议协办与会务工作

本次会议由济南槐荫经济开发区管理委员会和山东天岳先进科技股份有限公司协办。

会议期间，食宿统一安排，宿费自理。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议会务组：18709316115（会议会务）、010-62257692（缴费、发票）。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于2025年11月17日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息。本次会议收取会议费900元/人。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，11月17日之后及现场缴费收取1200元/人。汇款请注明：11月半材年会（个人汇款请备注单位名称）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：审定和讨论的标准项目

二〇二五年十月二十七日

抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会



附件：

审定和讨论的标准项目

序号	计划文号及编号	项目名称	主编单位	备注
第一组				
1	国标委发（2025）22号 20251025-Q-469	硅单晶单位产品能源消耗限额	TCL 中环新能源科技股份有限公司	审定
2	国标委发（2025）46号 20254825-Q-469	硅多晶和锗单位产品能源消耗限额	洛阳中硅高科技有限公司	审定
3	国标委发（2024）44号 20243061-T-469	300 mm 硅外延片	浙江丽水中欣晶圆半导体科技有限公司	审定
第二组				
4	国标委发（2024）44号 20243062-T-469	金刚石单晶抛光片	安徽光智科技有限公司	审定
5	国标委发（2025）43号 20253480-T-469	氮化铝单晶位错密度测试方法	中国电子科技集团公司第四十六研究所	讨论
6	国标委发（2025）47号 20254547-T-469	氧化镓单晶抛光片	杭州富加镓业科技有限公司	讨论
7	国标委发（2025）47号 20254761-T-469	碳化硅单晶片残余应力的测试光弹法	上海天岳半导体材料有限公司	讨论
8	中色协科字（2025）23号 2025-033-T/CNIA	碳化硅粉表面金属含量的测定电感耦合等离子体质谱法	山西烁科晶体有限公司	审定